

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-07-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位	富国基金、长城基金、中欧基金、惠升基金、西部利得基金、融通基金、英大基金、建信基金、前海开源基金、东方基金、奇盛基金、光大保德信基金、中银基金、嘉实基金、万家基金、鹏华基金、银华基金、东财基金、中海基金、金鹰基金、中信保诚基金、易方达基金、银河基金、明亚基金、信达澳银基金、上投摩根基金、大成基金、华泰柏瑞基金、半夏投资、海南棕榈湾投资、上海璞远资产、深圳展博投资、光大证券资管、华软新动力、韶夏资本、上海致君资产、森锦资管、北京源乐晟、工银理财、中国人寿资管、中船财务、上海明河投资、前海聚龙投资、安徽海螺创投、上海睿郡资管、湾区产融投资、福建海峡银行、拾贝投资、上海磐厚资管、天津远策投资、长江证券资管、上海鲍尔赛嘉投资、正中投资、谢诺投资、上海君和立成投资、圣为投资、正谊资本、上海保银投资、上海站观资管、灏浚投资、北京华平投资、深圳市远望角投资、杭州兆石投资、上海鲸域资管、未来资产大宇株式会社、海南进化论、招银理财、张家港金茂创投、湘江集团中盈投资、毓盛投资、知源投资、尊道投资、农银汇理、东方证券资管、兴证国际、德邦证券资管、复华证券投资信托、财信证券、东方证券、招商证券资管、财通证券资管、招商证券、中泰证券、安信证券、兴业证券、民生证券、华福证券、野村东方国际证券、方正证券、中信建投、中信证券、粤开证券、华金

	证券、个人投资者
时间	2022年6月27日——2022年7月1日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、王渝、肖晓月、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简介</p> <p>公司成立于1993年，持续深耕线路板产业链，从PCB样板起家，2012年开始进入IC封装基板领域，2015年通过收购美国HARBOR和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。公司坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统PCB到半导体测试板、IC封装基板的产品、技术和客户升级。自2018年起公司开始步入产能扩张阶段，目前前期投资产能正逐步释放，产能规模、收入规模逐步提升，公司成长空间进一步打开。</p> <p>2022年第一季度，公司实现营业收入127,247.69万元、同比增长18.82%，整体收入规模保持增长态势，归母净利润20,108.33万元、同比增长98.28%，扣非净利润12,109.08万元、同比增长10.56%。2022年制造业面临需求端通缩叠加成本端通胀压力，公司将继续保持战略定力，推动广州兴科IC封装基板项目的投资扩产及广州FCBGA封装基板项目、珠海FCBGA封装基板项目的投资建设，并积极提升自身的能力以应对宏观经济层面的不确定性和行业层面的竞争压力。</p> <p>二、IC封装基板规划介绍</p> <p>BT载板：目前广州生产基地2万平方米/月的产能已实现满产满销，整体良率保持在96%左右；与大基金合作的IC封装基板项目（广州兴科，由全资子公司珠海兴科实施）分二期投资，第一期规划的产能为4.5万平方米/月，第一条产线（1.5万平方米/月）目前进展顺利。</p> <p>FCBGA载板：广州FCBGA封装基板项目已启动建设前期准备工作，同步启动设备采购工作，计划2023年底前后建成产线、进入试产阶段。</p> <p>珠海FCBGA封装基板项目目前正常推进中。</p> <p>三、珠海和广州同时启动FCBGA封装基板项目投资的原因</p> <p>珠海FCBGA封装基板项目和广州FCBGA封装基板项目是两个独立的项目。当前全球FCBGA封装基板供应商有限，供应严重不足，且主要支</p>

持海外客户，无法满足国内下游客户的需要，国内市场需求旺盛。目前公司 FCBGA 封装基板团队已到位，利用珠海现成厂房进行项目建设，同步启动政府主管部门的审批备案，预计能较广州项目提前 1 年投产，将为广州项目积累试产经验和储备客户资源，同时投产后能降低 FCBGA 封装基板项目人工成本对利润的拖累，广州项目建设投产后，预计珠海项目已实现达产，进而实现投产、达产无缝衔接。

四、公司主要业务下游应用分布介绍

PCB：下游应用占比如下：通信约占 1/3，服务器、安防各占 15%-20%，工控、医疗各占 10%左右，其他行业约占 15%。公司 PCB 业务客户集中度低。

IC 封装基板：公司 FCBGA 封装基板项目尚未投产。目前 IC 封装基板以 BT 类载板为主，存储类载板是 BT 载板领域最大的下游市场，也是公司目前主要目标市场。下游应用占比如下：存储类占比约 2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关占比约 1/3，预计未来将维持前述产品结构。客户占比情况如下：国内客户占比约 2/3，中国台湾客户和韩系客户合计占比约 1/3，下游国内厂商正在积极扩产，是未来的主要增量市场所在。

五、IC 封装基板行业竞争格局预判

2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 144 亿美金，同比增速超 40%，IC 封装基板已超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分行业。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产必将带动 IC 封装基板和半导体测试板行业需求的增长，行业赛道好，玩家少。

公司在封装基板领域积累了丰富的经验(2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利)，且已通过三星认证，从侧面说明了公司的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可。

BT 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家。行业新进入者需要组建经验丰富的团队，在当前行业高景气度下团队组建成本较高，核心设备交付周期延长(18~24 个月)，且从组建团队、拿地建厂、装修调试到产能爬坡，完成大客户认证，保守估计至少需要 2~3 年时间，因此预计未来 2~3 年国内产业链供需格局预期仍乐观。

FCBGA 封装基板目前国内暂无量产企业，公司已完成团队组建，并同步启动设备采购和政府主管部门的审批备案，开始投资建设 FCBGA 封装基板项目。

六、半导体测试板业务介绍

半导体测试板是芯片测试环节的基础耗材，产品应用从晶圆测试到封装后芯片测试各环节，产品类型包括探针卡、负载板和老化板，目前国内参与企业较少，公司半导体测试板业务在国内规模领先，2021 年实现营收 41,687.12 万元，毛利率 20.34%。公司半导体测试板业务的主要经营主体为子公司美国 Harbor 及广州科技，Harbor 在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为全球一流半导体公司。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

测试板业务与样板业务经营模式类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。未来随着广州基地产能逐步释放，交期和良率指标的改善，2022 年公司半导体测试板业务收入规模有望进一步提升。

七、宜兴批量板业务介绍

宜兴批量板主要为 8 层以上高、多层线路板，主要应用于 5G、光模块、服务器、安防等领域，目前已通过大客户认证，顺利导入批量订单，随着扩产的推进，批量板营收占 PCB 营收比例将逐步提升。

八、下游应用领域未来景气度预判

从产品结构看，呈现结构分化的增长趋势：高端产品的景气度较高，中低端产品随着产品更新迭代和技术升级，需求会相对弱一些。根据 Prismark 的预测，未来五年增速最快的领域是 IC 封装基板和多层板领域。从应用领域看，服务器领域是今年景气度最高的下游行业，对宜兴硅谷有较大贡献；通信行业的增长情况取决于 5G 推动的进度，宜兴硅谷已突破通信行业大客户的 5G 认证，未来形势向好；安防、工控、轨道交通等行业的增长相对平稳；医疗方面目前因疫情影响市场景气度较好，从长期看表现平稳；汽车电子方面，总量没有大的增长，结构会从传统汽车转向新能源汽车。受 5G、AI、大数据、物联网、智能驾驶等领域快速发展的拉动，芯片需求量持续增长，高端芯片的紧缺程度持续提升，作为

	<p>核心材料的 IC 封装基板未来几年的增速会显著高于 HDI 板、多层板、纸基板、双面板和 FPC 等产品。</p> <p style="text-align: center;">九、公司未来的战略方向</p> <p>基于对产业趋势的判断、客户需求及公司自身技术、产品升级需要，公司未来的重点工作是推动广州兴科 IC 封装基板项目的投资扩产及广州 FCBGA 封装基板、珠海 FCBGA 封装基板项目的投资建设。传统 PCB 业务也是公司的主要收入和利润贡献来源之一，未来主要通过提升研发能力、数字化改造、加强与大客户的合作深度等方面来提升传统 PCB 业务的竞争力，实现效率提升和平稳增长。长期来看，随着公司 IC 封装基板业务的逐步投产和达产，未来半导体业务的收入和利润占比将会逐步提升。</p> <p style="text-align: center;">十、定增项目的计划</p> <p>公司定增项目已经接触了不少有认购意向的投资者。公司将在批文有效期届满前（2022 年 10 月 19 日）择机发行。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 27 日——2022 年 7 月 1 日